

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2025-082

鸿日达科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿日达”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,167万股，每股发行价为14.60元，应募集资金总额为人民币75,438.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,855.35万元后，实际募集资金金额为67,582.85万元。该募集资金已于2022年9月23日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）原募投项目投资情况

1、首次公开发行股票的募集资金投资项目名称：昆山汉江精密连接器生产项目。

2、公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“昆山汉江精密连接器生产项目”进行调整，在原实施主体汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）的基础上，增加公司另一全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）为募投项目的实施主体，在原实施地点江苏省苏州市昆山玉山镇青淞路29号的基础上，增加江苏省东台市经济开发

区东渣路东侧、东区四路北侧为募投项目的实施地点，同时增加东台润田为主体的募集资金专户，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建厂房。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的公告》（公告编号：2023-054）。

3、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中部分内容变更为“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。

4、公司于 2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“昆山汉江精密连接器生产项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 3 月 31 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。

5、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 11 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-028）。

（三）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	募集资金累计已投入金额
承诺投资项目			
昆山汉江精密连接器生产项目	23,687.01	23,687.01	13,171.37
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000
汽车高频信号线缆及连接器项目	15,765.83	7,137.91	1,240.66

半导体金属散热片材料项目	11,428.17	11,428.17	5,880.94
承诺投资项目小计	56,881.01	48,253.09	26,292.97
超募资金投向			
归还银行贷款	-	5,700.00	5,700.00
永久补充流动资金	-	5,700.00	5,700.00
汽车高频信号线缆及连接器项目	-	7,929.76	-
超募资金投向小计	-	19,329.76	11,400
合计	56,881.01	67,582.85	37,692.97

注 1：“汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83 万元，具体由募集资金 15,067.67 万元（含超募资金 7,929.76 万元）、自有资金 698.16 万元构成。

注 2：截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金余额合计为 30,140.06 万元（含利息及理财收益），其中募集资金专户余额为 8,745.06 万元，尚未到期的现金管理产品 21,395.00 万元。

二、本次拟变更部分募投项目概况及原因

公司原募投项目中“昆山汉江精密连接器生产项目”、“汽车高频信号线缆及连接器项目”是基于当时消费电子产品更新迭代速度加快、顺应汽车新能源化和电动化、相关产品市场需求旺盛等行业趋势以及公司发展战略而制定，但在项目实际执行过程中，由于宏观经济环境、行业周期性、市场竞争格局变化，相关产品市场需求变动较快，导致两个募投项目推进缓慢，若公司持续投入较多资源，将不利于公司应对目前的市场环境和行业发展，预计也将无法达到募投项目最初预估的投资收益。为更好保护公司及全体股东的利益，提高募集资金的使用效率，公司根据当前发展现状及整体战略规划，出于项目实施进度和新产能投入的轻重缓急综合考虑，拟减少“昆山汉江精密连接器生产项目”、“汽车高频信号线缆及连接器项目”的投资总额，改变其部分募集资金投向，紧抓市场机遇，建设优质产能，进一步提升公司在新产品领域的市场竞争力和盈利能力。

面对复杂多变的外部宏观环境，公司主动调整战略规划，积极寻求应对市场变化的经营策略、并适时布局和调整公司产品的研发方向。在综合考量细分行业发展前景、下游客户应用场景和需求等多种因素后，公司决定依托现有技术积累，通过内延式研发创新突破、以及外部专业人才团队引入等途径，逐步向光通信设备、半导体封装高端引线框架等应用领域和细分赛道布局与拓展，积极开发新技术和新产品，现已取得一定的研发成果。但由于客户对订单交付时效与服务响应效率要求较高，公司计划加快建设光通信设备、半导体

封装高端引线框架业务，加大资源投入，以提升产品交付能力，巩固并提升竞争优势。

经审慎分析后，公司拟变更原募投项目中“昆山汉江精密连接器生产项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”的部分募集资金用途，用于开展“光通信设备项目”和“半导体封装高端引线框架项目”（以下简称“半导体引线框架项目”），以进一步推进公司在光通信领域、半导体封装高端引线框架领域的布局，提高募集资金的使用效率与投资回报。其中，“光通信设备项目”由鸿日达实施，“半导体引线框架项目”由新设控股子公司鸿科半导体（东台）有限公司（以下简称“鸿科半导体”）实施。

本次变更后，公司拟开展的募投项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	变更前		变更后	
		项目总投资	拟投入募集资金	项目总投资	拟投入募集资金
昆山汉江精密连接器生产项目	东台润田	23,687.01	23,687.01	18,479.24	18,479.24
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
汽车高频信号线缆及连接器项目	东台润田	15,765.83	15,067.67	3,411.20	3,411.20
半导体金属散热片材料项目	东台润田	11,428.17	11,428.17	11,428.17	11,428.17
光通信设备项目	鸿日达	-	-	7,864.24	7,864.24
半导体封装高端引线框架项目	鸿科半导体	-	-	11,740.48	9,000
合计		56,881.01	56,182.85	58,923.33	56,182.85

注 1：“半导体封装高端引线框架项目”总投资共计为 11,740.48 万元，具体由募集资金 9,000 万元（含超募资金 7,929.76 万元）、鸿科半导体自有资金 2,740.48 万元构成。

注 2：本次拟变更用途的募集资金金额为 16,864.24 万元，占募集资金净额 67,582.85 万元的 24.95%。

三、新增募投项目情况

（一）光通信设备项目

1、实施主体：鸿日达科技股份有限公司

2、实施地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司。

3、建设内容与规模：本项目拟利用现有厂房进行适应性装修改造，项目涉及总建筑面积约 4,000.00 平方米；本项目建成后，主要研发和生产光通信设备，包括 FA-MT、MT-MT、光纤跳线、MPO 跳线、陶瓷组件、毛细管尾纤适配器等，产出产品全部对外销售；同时开

展高速铜缆加工业务，收取加工费。

4、建设周期：项目计划建设周期为 1.5 年。

5、投资构成：

序号	总投资构成	金额（万元）	占百分比(%)
1	建设投资	6,739.73	85.70%
1.1	工程费用	6,307.25	80.20%
1.1.1	适应性工程改造	170.25	2.16%
1.1.2	设备费用	6,137.00	78.04%
1.2	工程建设其他费用	111.54	1.42%
1.3	预备费	320.94	4.08%
2	流动资金	1,124.51	14.30%
合计		7,864.24	100.00%

6、经济效益分析

根据可行性研究报告，项目投资财务内部收益率（税后）为 23.54%，项目投资回收期（税后）为 5.25 年（含建设期），项目具有经济效益和盈利能力。该经济效益分析为公司结合目前市场现状和未来发展预期而作出的测算，不构成对公司未来业绩的承诺。

7、可行性分析

在 5G 通信网络、数据中心、智能汽车、工业互联网等前沿领域，光通信设备均发挥着无可替代的基础支撑作用。伴随 5G 网络的深度覆盖、数据中心规模的持续扩张、AI 技术在各行业的深度渗透，光通信市场将迎来更为广阔的增长契机。本项目建成后生产的 FA-MT、MT-MT、光纤跳线等光通信设备，其生产的产品具备高速率、高稳定性优势，可满足 5G 网络、数据中心等场景的传输需求，契合相关产业政策要求。同时，近年出台的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《“十四五”数字经济发展规划》等国家及地方文件持续推进，为光通信产业提供了有力政策支撑。鸿日达作为技术驱动的高新技术企业，始终秉持“技术引领、创新赋能”理念，在精密制造领域深耕多年，已形成完善的技术研发与成果转化体系。公司在光通信领域精准掌握 FA-MT、MT-MT、光纤跳线、MP0 跳线、陶瓷组件等产品的研发与生产技术，拥有的多项专利可直接应用于光通信设备生产，可提升产品性能与生产良率。

（二）半导体封装高端引线框架项目

1、实施主体：鸿科半导体（东台）有限公司

2、实施地点：东台经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧

3、建设内容与规模：本项目拟租用公司全资子公司东台润田 6,308 平方米现有厂房作为生产基地，同时购置先进的进口与国产设备，生产半导体封装用高端蚀刻引线框架；项目建成后，将形成年产 1,400 万条半导体封装高端蚀刻引线框架的生产能力，产品具有导电及导热率高、耐腐蚀性能好等特点。

4、建设周期：项目计划建设周期为 3 年。

5、投资构成：

序号	总投资构成	金额（万元）	占百分比(%)
1	建设投资	9,507.51	80.98%
1.1	工程费用	9,175.10	78.15%
1.1.1	装修工程	1,400.00	11.92%
1.1.2	设施工程	400.00	3.41%
1.1.3	设备费用	7,275.10	61.97%
1.1.4	IT 系统和软硬件	100.00	0.85%
1.2	工程建设其他费用	100.52	0.86%
1.3	预备费	231.89	1.98%
2	流动资金	2,232.97	19.02%
合计		11,740.48	100.00%

6、经济效益分析

根据可行性研究报告，项目投资财务内部收益率（税后）为 16.91%，项目投资回收期（税后）为 5.94 年（含建设期），项目具有经济效益和盈利能力。该经济效益分析为公司结合目前市场现状和未来发展预期而作出的测算，不构成对公司未来业绩的承诺。

7、可行性分析

半导体封装高端引线框架是封装环节的核心部件，承担芯片与外部电路的电连接、散热疏导及机械防护功能，是保障集成电路性能的“关键桥梁”，更是推动先进封装技术创新突破、保障集成电路性能稳定的重要引擎。近年来，AI、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场加速渗透，带动下游芯片向“高集成、高可靠、耐候性”需求升级，进而推动全球先进封装产业增长，高端引线框架需求爆发。对此，国家高度重视半导体产业

链自主可控，将封装及核心部件国产化纳入战略，出台《“十四五”数字经济发展规划》等政策，明确支持高端引线框架发展；地方政府配套产业基金、研发补贴、税收优惠、用地倾斜等措施，从多维度为项目技术攻关、产能建设提供支撑，奠定项目实施基础。同时，鸿日达以及控股子公司鸿科半导体在半导体封装高端引线框架领域已积累了一定的技术储备及客户资源，为本项目的顺利开展奠定了坚实的基础。

（三）上述项目实施面临的主要风险和控制措施

1、市场需求风险和控制措施

项目建成投产后，可能会面临市场需求降低、产品销路少、供大于求的风险。由于目前有关部门出台的一系列相关政策都在大力提倡半导体先进封装和光通信行业发展，因此，本项目的市场需求的风险发生的概率较低，若发生，对该项目产生的影响程度较小。

针对上述风险，公司将利用自身优势，加强与各级政府沟通，争取与大型央企、国企公司合作；考察客户信誉，对客户进行充分的调查，建立客户档案，进行长效管理，及时跟踪、掌握客户各个方面变化情况；注重市场开拓，加快投入资金向效益结算资金的转化，保持良好的资金流动。

2、产业链供应链的风险和控制措施

在项目建成后生产产品的过程中，可能面临产业链供应链循环不畅、基础不牢、水平不高的问题，关键材料的质量和供应的稳定性可能出现問題。由于企业自身实力雄厚且对抗风险的韧性高，对供应商的选择进行了严格把控，且生产流程成熟，因此，本项目的产业链供应链的风险发生的概率较低，若发生，该风险对项目的影响程度中等，不会带来较严重的后果。

针对上述风险，公司将对产业链供应链分门别类进行分析、评价，识别关键结点、关键企业，建立产业链供应链风险预警机制，跟踪关键节点和关键链路上的风险，提升对重大安全隐患进行预测和适应性调整的能力，将有限的资源精准配置到每个节点和链路上。

3、运营管理的风险和控制措施

项目由于管理活动与经济需求发展不匹配，而给投资者可能带来经济损失的风险。本项目属于建设单位的重点投资项目，管控严格，因此，发生运营管理风险的概率很低，若发生，其风险对项目的影响程度较大，可能会带来严重的后果。

针对上述风险，公司将积极探索学习成功的企业管理经验，提高公司业务服务水平，建立良好品牌效应；控制和规避投资风险，抓住时机，继续加大公司宣传力度，完善公司

相关的软、硬件设施，采取切实可行的措施，以实现项目预期的经济效益和社会效益；在后期运营过程中形成反馈机制，不断提高服务水平和质量，打出品牌效应，脱离价格竞争行列。

四、关于向子公司实缴出资以实施募投项目的情况

半导体封装高端引线框架项目中，由于鸿科半导体为新设主体，公司将通过实缴出资方式划转项目实施所需资金，鸿科半导体少数股东将按其认缴出资额及公司章程约定的出资时限完成出资，各方出资价格一致。

鸿科半导体的股东福建特度科技有限公司、上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）在半导体引线框架领域具有丰富的生产经营管理经验以及客户资源，能为“半导体封装高端引线框架项目”的产品开发、技术研发、销售渠道等方面提供大力支持。

（一）鸿科半导体（东台）有限公司的基本情况

统一社会信用代码：91320981MAK10GG50P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：15000 万

法定代表人：常旭

成立日期：2025 年 11 月 17 日

住所：东台经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧一期厂房 4 号楼一、二层

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	鸿日达科技股份有限公司	60%
2	福建特度科技有限公司	20%
3	上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）	20%
合计		100%

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；有色金属合金销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务状况：暂无财务数据。

（二）本次实缴出资后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理，公司拟安排实施主体鸿日达、鸿科半导体分别开设对应的募集资金专户。后续公司、控股子公司、专户开户银行、保荐机构将签署募集资金专户存储监管协议，同时提请股东会授权公司经营层全权办理与本次变更部分募投项目的后续相关事宜，包括但不限于与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议并开立募集资金专用账户、根据实际需要安排项目支出等。

五、本次变更部分募投项目对公司的影响及风险提示

（一）对公司的影响

本次募集资金投资项目变更，系公司审慎考虑市场环境、公司经营情况和公司发展战略后进行的必要调整，有利于公司提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，符合行业发展趋势及公司未来发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。后续公司将在现有业务基础上，积极开发和拓展与主业关联度较高的新业务，落实公司新的战略布局和规划。

（二）风险提示

1、本次变更部分募投项目的议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不能通过股东会审议的风险。

2、上述两个新项目均面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素，从而影响建设进度的情形，因此存在导致该募投项目无法在达到预定可使用状态日期前顺利完成的

六、相关决策程序及专项意见

（一）独立董事审查意见

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。独立董事认为：本次部分募集资金用途变更事项，是公司结合自身实际情况和经营计划做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）审计委员会意见

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第八次例会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。审计委员会认为：本次变更部分募投项目内容是公司基于市场环境、实际经营情况和未来发展战略进行的必要调整，符合公司的业务发展规

划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该事项。

（三）董事会意见

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：鸿日达变更部分募投项目事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提请公司股东会审议批准后方可实施，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审查意见；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第八次例会决议；
- 3、第二届董事会第十九次会议决议；
- 4、东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日